

SMIC(中芯国際):特許ポートフォリオ・R&D投資およびIPエコシステム構築ファクトブック

1. 知的財産権および特許ポートフォリオの実績

Semiconductor Manufacturing International Corporation(以下、SMIC)の法定開示および公式発表資料によると、同社は自主開発のプロセスを堅持し、自主化された中核的知的財産権を強固にする方針を掲げている¹。

2025年12月31日を対象期間とするFY2025実績(Annual Report開示)において、SMICは累計で20,403件の特許出願を実施している¹。同日時点において累計で取得および授権された特許数は14,511件に達している¹。このうち、発明特許は12,621件、実用新案特許は1,890件である²。さらに、集積回路の布図設計権(レイアウトデザイン権)については、同日時点で累計94件を取得している²。SMICの2025 Annual Reportの記述によれば、これらの出願および授権特許数は中国大陸の半導体製造業において先行する規模であるとの注記が付されている¹。

また、2025年6月30日を対象期間とする2025年半年度実績の公表数値において、累計で授権された特許数は14,215件であった³。この時点での内訳は、発明特許が12,342件、実用新案特許が1,873件であり、集積回路の布図設計権は94件であった³。同期間(2025年上半期実績)における新規特許出願数は合計103件であり、内訳は発明特許98件、実用新案特許5件であった³。同時に、新規に取得した特許数は合計251件であり、内訳は発明特許230件、実用新案特許21件であった³。SMICは、知的財産権の保護と技術情報の管理に関する取り組みとして、情報セキュリティ管理システム認証(ISO 27001)を取得している事実を開示している³。

2. 研究開発(R&D)体制と関連投資実績

SMICの研究開発(R&D)活動は、顧客の需要に基づき、プロセス技術の反復的更新や製品性能のアップグレードを持続的に推進することを目的として展開されている²。

2025年通期を対象期間とするFY2025実績において、SMICのAnnual Reportに記載された研究開発投資額は774 million USDであり、これは同年の売上高に対して8.3%の割合を占めている²。当該資料の別の記載箇所においては、2025年の研究開発費用実績を773.6 million USDと記述しており、前年であるFY2024実績の765.3 million USDから増加した事実が確認できる²。

四半期ごとの推移に関して、2026年第1四半期を対象期間とする1Q26監査未済実績における研究開発費用は187,097千USD(約187.1 million USD)であった⁵。この数値は、前四半期である2025年第4四半期(4Q25実績)の研究開発費用239,676千USDと比較して21.9%の減少(増減率-21.9%)である⁵。同時に、前年同期である2025年第1四半期(1Q25実績)の研究開発費用148,899千USDと比較した場合は25.7%の増加(増減率25.7%)となっている⁵。前四半期比での減少要因について、SMICの1Q26決算開示資料は、1Q26における研究開発活動の水準が低下したことによるものと記述している⁵。

研究開発の組織体制について、SMICは集積回路(IC)の研究開発実践を通じ、コアマネジメントチームとともに専門的な研究開発チームを構築している²。研究開発チームの主要メンバーは、業界特有の研究開発およびマネジメント経験を有するシニアエキスパートで構成されている²。さらに、人材戦略の一環として、若手幹部の選抜・育成、新卒者の採用強化、ならびに専門的なエリートやハイ

エンドの専門家の導入を推進し、人材パイプラインの開発と多様な報酬システムの導入を実施している²。

技術開発の外部連携に関して、SMICは上流および下流のパートナーと産業チェーンの協力を実施しており、先端パッケージング研究院(advanced packaging research institute)を設立した事実を開示している²。

3. IPエコシステムおよびデザインサービス網の展開

SMICは顧客に対して「一站式(ワンストップ)」の晶円代工(ウェハファウンドリ)および技術サービスを提供するため、8インチおよび12インチの多様な技術プラットフォームの開発を行っている³。同社は公式ウェブサイト上においてサービスチェーンの構成を開示しており、テクノロジープラットフォーム(プロセス/PDK、IP設計/サービス/実績、アプリケーションプラットフォーム)、デザインサポート(顧客向けAEサポート、リファレンスフロー)、およびテープアウト/アセンブリ/テストの各領域を網羅している⁶。

IPエコシステムの具体的な提供事例として、SMICは過去の公式リリースにおいて、自社のUHD(Ultra High Density)IPライブラリと、Mentor Graphics(NASDAQ: MENT)のcool-memory IPライブラリを統合した0.11μm UHD IPソリューションに関する情報を公開している⁶。SMICの自社UHDライブラリは、6トラックUHDスタンダードセルライブラリ、UHDメモリコンパイラ、UHDスタンダードI/Oライブラリによって構成されている⁶。公式リリースによれば、この統合IPソリューションは異なる構成を生成して電力、速度、および密度を最適化することが可能であり、SMICの顧客に対して無償で提供される⁶。また、同資料には、SMICの0.11μm UHD IPソリューションを使用することで、従来のIPライブラリを使用する設計と比較した場合、典型的なSOC設計においてチップサイズを31%縮小することが可能であるとの記述がある⁶。当該リリースの発表時点において、SMICは既存のCu-BEoLプラットフォーム上で0.11μm IPライブラリを採用したウェハの累計出荷量が100,000枚を超えている旨を報告している⁶。

環境および品質管理に関する認証実績として、SMICは有害物質プロセス管理システム(Hazardous Substance Process Management System)に関するIECQ HSPM QC 080000のシステム監査に合格した事実(2007年1月9日付発表)、およびソニーの「グリーンパートナー」環境品質承認プログラムの認証を取得した事実(2005年発表)を開示している⁸。

IPエコシステムおよびサービスチェーンの構成要素	詳細内容(公式開示に基づく)
テクノロジープラットフォーム	Mixed Signal & RF、プロセス/PDK、IP設計/サービス/実績、アプリケーションプラットフォーム
デザインサポート	顧客向けAEサポート(AE Support for Customer)、リファレンスフロー
エコシステム・パートナーシップ	Mentor Graphicsとの0.11μm UHD IPソリューション統合・無償提供

バックエンド・サービス	テープアウト、アセンブリ、テスト、マスクサービス
製造ネットワーク	8インチおよび12インチウェハ対応マルチプロジェクトウェハサービス

4. 知的財産権に関連する訴訟・和解および法的対応

TSMCとの特許およびトレードシークレット訴訟の和解(2005年合意)

SMICは、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.(以下、TSMC)との間で係争中であった複数の特許侵害およびトレードシークレットの流用疑惑に関する訴訟について、2005年1月30日付で和解合意書(Settlement Agreement)を締結した¹¹。

この和解合意書の締結により、両社間で進行中であった未決の法的手続き(米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所におけるCivil Action No. C03-5761 MMCおよびNo. C04-3390 MJJ、米国国際貿易委員会における337-TA-525、台湾新竹地方法院におけるCase No.

91-Chai-Chuan-235、およびカリフォルニア州上級裁判所における訴訟)は、偏見なし(without prejudice)で取り下げられた¹¹。この和解において、いずれの当事者も法的責任(liability)を認めるものではない旨が合意事項の条件として明記されている¹²。

和解の財務的条件として、SMIC(Cayman)はTSMCに対し、総額175 million USDを6年間の分割払いで支払う義務を負った¹³。この支払額のうち、20 million USDは過去分に割り当てられ、残額の配分については両当事者が独立して決定することとされた¹¹。SMICの支払い義務は取り消し不能であり、TSMCに提供される一連の約束手形によって担保されるスキームが採用された¹¹。

特許ライセンス契約(Patent License Agreement)の側面として、両社は2005年1月から2010年12月までの期間において、互いの特許ポートフォリオをすべての半導体デバイス製品に対してクロスライセンスすることに合意した¹²。

トレードシークレットに関して、和解合意書はSMICに対してTSMCのいかなるトレードシークレットを使用するライセンスをも付与するものではないと規定している¹³。その上で、TSMCは一定の条件のもと、SMICの0.15 μ mおよびそれ以上のプロセスに関連する特定のトレードシークレット流用疑惑に関してSMICを提訴しない旨の誓約(Covenant not to sue)を行った¹²。この誓約は、和解合意書の締結から6か月後(2005年7月31日以降)の0.13 μ mおよびそれ以下の技術には適用されないが、それ以外の技術についてはSMICによる違反による終了条項を除き、無期限に有効であると定められた¹²。なお、SECへの開示書類において、TSMCは和解合意書の効力発生後、SMICが0.13 μ m製品の製造および設計ルールにおいてTSMCの情報を使用していることを認識していたとする記録が示されている¹¹。

会計処理上、SMICは175 million USDの支払いのうち和解金として計上された158 million USDの配分を変更し、10.6%(16.7 million USD)を和解日以前の訴訟解決分とし、89.4%(141.3 million USD)を和解日以降の特許ライセンスポートフォリオの無形資産(後に繰延費用として再分類)として割り当てた事実をAnnual Report等で開示している¹²。

SMIC New Technologyの仲裁案件

SMICの2025 Annual Reportによると、子会社であるSMIC New Technologyに関する仲裁判断の係争が進行中である²。SMIC New Technologyは、下された仲裁判断が「明白に不当 (manifestly improper)」であり、「重要な手続き上の不規則性および極めて重要な法的原則の適用における実質的な誤り」を含んでいると主張している²。当該Annual Reportの報告日時点において、SMIC New Technologyはこの仲裁判断を取り消すため、香港特別行政区高等法院 (High Court of the Hong Kong Special Administrative Region) に対し申請を行うという法的措置を講じている²。

役員に対する香港証券先物委員会 (SFC) の法的手続き

SMICの独立非執行役員であるFan Ren Da Anthony博士は、外部企業における職務に関連する法的手続きに関与している²。2025年3月14日、香港証券先物委員会 (SFC) は、Hong Kong Resources Holdings Company Limited (HKRH、現3DG Holdings (International) Limited) の元取締役8名に対する法的手続きを第一審裁判所 (Court of First Instance) で開始した旨のニュースリリースを発表した²。Fan Ren Da Anthony博士はこの8名の元取締役の1人に該当し、SFCは同取締役らがHKRHに対して負う義務に違反したと主張し、資格剥奪および補償命令を求めている²。SMICの2025 Annual Reportの報告日時点において、第一審裁判所は同氏に対していかなる拘束力のある決定も下していない²。

一般的な知財訴訟リスクの開示

SMICは、2024年および2025年のAnnual Report等の「前瞻性陳述の重大リスク提示 (Forward-Looking Statements)」セクションにおいて、未決の訴訟による命令または判決、および半導体業界で一般的な知的財産権訴訟 (common intellectual property litigation in the semiconductor industry) を、自社の実際の業績、財務状況、または経営結果が期待と大きく異なる原因となり得る重要な不確実性要因として定型的に開示している²。

5. 事業概要および財務・生産実績

SMICは、集積回路 (IC) ウェハファウンドリビジネスを中心に、設計サービス、IPサポート、フォトマスク製造等の付随サービスを提供する事業モデルを採用している¹⁶。同社は中国大陸内に製造ハブを置き、グローバルに事業を展開している。証券コードは、香港証券取引所 (SEHK) において「00981」、上海証券取引所科创板 (SSE STAR MARKET) において「688981」として上場している¹⁷。従業員総数は19,952人である¹⁸。

2025年通期実績

2025年通期を対象期間とするFY2025監査未済実績において、SMICの売上高は9,326.8 million USDであり、前年である2024年の8,029.9 million USDから16.2%の増加 (前年比16.2%増) を記録した⁴。売上総利益率 (Gross margin) は21.0%であり、前年の18.0%から3.0パーセントポイント上昇した¹⁷。親会社の所有者に帰属する利益 (Profit attributable to owners of the Company) は685.1 million USDであり、2024年の492.7 million USDから39.1%の増加となった¹⁷。この利益増加の主要な要因として、SMICはウェハ出荷量の増加、設備稼働率の向上、および製品ミックスの変化を挙げている¹⁷。

生産能力に関するFY2025実績として、2025年末時点の月間生産能力は1,059千枚(8インチ標準論理ウェハ換算)に達し、前年末と比較して約111千枚増加した¹⁷。2025年通期の総出荷量は約970万枚(9.697 million wafers)であり、年間ベースの設備稼働率は93.5%となり、前年から8パーセントポイント上昇した¹⁷。2025年の設備投資額(Capital expenditure)は8.1 billion USD(81億USD)であった¹⁷。

四半期単体の2025年第4四半期(4Q25実績)において、売上高は2,488.7 million USDであり、前四半期である2025年第3四半期の2,381.8 million USDから4.5%増加した¹⁷。4Q25の売上原価(Cost of sales)は2,010.6 million USD、売上総利益は478.1 million USDであった¹⁷。4Q25の売上総利益率は19.2%であり、前四半期の22.0%から低下したが、その要因として減価償却費の増加が記載されている¹⁷。4Q25の営業費用(Operating expenses)は179.5 million USDであり、当該四半期の設備投資額は2,407.5 million USDであった¹⁷。

2026年第1四半期実績

2026年第1四半期を対象期間とする1Q26監査未済実績において、売上高は2,505.5 million USDであった⁵。これは前四半期(4Q25)の2,488.7 million USDから0.7%の増加であり、前年同期(1Q25)の2,247.2 million USDからは11.5%の増加となっている⁵。

1Q26の売上原価は2,001,884千USDであり、売上総利益は503,603千USDであった⁵。1Q26の売上総利益率は20.1%であり、前四半期の19.2%から0.9パーセントポイント上昇した⁵。この利益率上昇の要因として、製品ミックスの変化および平均販売価格の上昇が記述されている⁵。

1Q26の営業費用は255,811千USDであり、前四半期の179,501千USDから42.5%増加した⁵。営業費用の内訳において、一般管理費(General and administrative expenses)は118,218千USDであり、前四半期の145,680千USDから18.9%減少したが、これは立ち上げ費用の減少が要因とされている⁵。販売およびマーケティング費用(Selling and marketing expenses)は9,667千USDであった⁵。その他の営業収入(Other operating income)はマイナス58,800千USDであり、政府資金の認識収入の変動が要因として記載されている⁵。

1Q26の営業利益(Profit from operations)は247,792千USDであった⁵。その他の純収益(Other income, net)は7,539千USDの利益となり、前四半期の72,117千USDの損失から改善した⁵。

2026年会社予想

SMICは、外部環境に重大な変化がないという前提に基づき、2026年通期(FY2026会社予想)のガイダンスを示している¹⁷。売上高の成長率について、同じ市場の業界平均を上回ることを見込んでいる¹⁷。設備投資額については、2025年の実績(8.1 billion USD)と概ね横ばいになることを見込んでいる¹⁷。

四半期予想として、2026年第2四半期(2Q26会社予想)のガイダンスにおいて、売上高は前四半期比で14%から16%の増加を見込んでいる⁵。売上総利益率については20%から22%の範囲内を見込んでおり、これは前四半期のガイダンス(または実績)と比較して2パーセントポイントの上昇に相当する数値として示されている⁵。

指標(単位)	FY2024(実績)	FY2025(実績)	1Q26(実績)	2Q26(会社予想)

売上高 (million USD)	8,029.9	9,326.8	2,505.5	前四半期比 +14%~16%
売上総利益率 (%)	18.0%	21.0%	20.1%	20.0%~22.0%
当期純利益 (million USD)	492.7	685.1	-	-
設備投資額 (billion USD)	-	8.1	-	通期で前年と概ね横ばい
月間生産能力 (千枚)	約948	1,059	-	-

※月間生産能力は8インチ標準論理ウェハ換算。当期純利益は「親会社の所有者に帰属する利益」。

6. 組織および主要子会社展開

SMICは中国大陸内の主要都市に製造ハブを構築している。上海拠点にはSMIC Shanghai、SMSC、SMOCが配置され、北京拠点にはSMIC Beijing、SMNC、SMBCが配置されている²。天津拠点にはSMIC Tianjin、SMTCが、深圳拠点にはSMIC Shenzhenが配置されている²。

子会社に関する資本取引として、SMSC (Semiconductor Manufacturing South China Corporation) に関して新規の資本注入および株式拡張契約が締結されており、同社の登録資本金は6.5 billion USDから10.0773 billion USDに増額された²。この契約に基づく各出資者の持分は、SMIC Holdingsが41.561%、China IC Fundが9.392%、China IC Fund IIが14.885%、China IC Fund IIIが8.361%、Shanghai IC Fundが7.939%、Shanghai IC Fund IIが11.253%、Taixin Dingjiが5.545%、Pioneer IC Fundが1.063%となっている²。

また、SMICは子会社であるSMNC (Semiconductor Manufacturing North China (Beijing) Corporation) の株式49%をベンダー (China IC Fund、Semi Investment Center、E-Town Capital、ZGC Development、Beijing Industrial Development等) から取得する計画を発表している²⁰。取得対価として特定のマニフェストに基づくRMB株式 (Consideration Shares) の発行を伴うスキームが採用され、新RMB株式の発行価格は、価格決定基準日 (2025年9月9日) の直近20日、60日、または120取引日の平均取引価格の80%を下回らないものと規定された (直近20日の平均取引価格実績は99.56 RMBであり、その80%は79.65 RMBと算定されている)²⁰。

主要子会社・ジョイントベンチャー一覧

SMICの2025 Annual Reportに記載された、直接的または間接的に保有する主要な子会社およびジョイントベンチャー等の拠点は以下の通りである²。

会社名	登録場所	登録資本金	議決権・持分比率	主要事業内容
SMIC Shenzhen	PRC	USD 2,415,000,000	55.05% (間接)	半導体製品の 製造および販 売
SMNC	PRC	USD 4,800,000,000	51.00% (間接)	半導体製品の 製造および販 売
SMSC	PRC	USD 10,077,300,00 0	40.06% (間接)*	半導体製品の 製造および販 売
SMBC	PRC	USD 5,000,000,000	54.04% (間接)	半導体製品の 製造および販 売
SMOC	PRC	USD 5,500,000,000	69.97% (間接)	半導体製品の 製造および販 売
SMTC	PRC	USD 5,000,000,000	100.00% (間 接)	半導体製品の 製造および販 売
SMIC New Technology	PRC	USD 400,000,000	100.00% (間 接)	研究開発活動
Hulintong Industrial (Shanghai) Co., Ltd	PRC	USD 8,000,000	100.00% (間 接)	半導体製品の 取引およびサー ビス
Better Way Enterprises Limited	Samoa	USD 1,000,000	100.00% (直 接)	マーケティング 関連活動

SMIC, Americas	United States	USD 500,000	100.00% (直接)	マーケティング関連活動
SMIC Japan Corporation	Japan	JPY 10,000,000	100.00% (直接)	マーケティング関連活動
SMIC Europe S.R.L	Italy	EUR 100,000	100.00% (直接)	マーケティング関連活動
SMIC (BVI) Corporation	BVI	USD 10	100.00% (直接)	マーケティング関連活動
SMIC Investment (Shanghai) Corporation	PRC	USD 465,800,000	100.00% (直接)	投資持ち株
SMIC Holdings Corporation	PRC	USD 5,950,000,000	100.00% (直接)	投資持ち株
China IC Capital Co., Ltd	PRC	RMB 3,458,000,000	100.00% (間接)	投資持ち株
China IC Capital (Ningbo) Co., Ltd	PRC	RMB 4,000,000,000	100.00% (間接)	投資持ち株

*注記: SMSCについて、持分比率は40.06%であるが、SMIC Holdingsが取締役の過半数を任命する権利を有し、特定の重大事項に対する拒否権を持つため、実質的な支配権を有する子会社として連結されている²。

7. IRイベントおよび総会決議事項の進捗

SMICが公表した直近のIRイベントおよび株式・企業統治に関する主な活動日程と事実は以下の通りである。

日付	事項・ステータス	内容(公式開示に基づく)	出典
----	----------	--------------	----

2026年2月10日	完了	2025年第4四半期および通期の監査未済実績の発表。	[cite: 17]
2026年2月11日	完了	決算発表に関するWebcastおよびカンファレンスコールの実施。	[cite: 17]
2026年2月12日	完了	子会社SMNCの49%持分取得等に関する臨時株主総会(EGM)の開催。	[cite: 20]
2026年3月26日	完了	取締役会による財務諸表の承認、および2025年Annual Resultsの発表。	[cite: 4]
2026年5月14日	完了	2026年第1四半期の監査未済実績の発表。	[cite: 5]

また、次回の年次株主総会(AGM)において、SMICは以下の議案を提案する方針を示している²¹。

1. 2025年度の利益分配計画
2. ヘッジビジネスへの従事の提案
3. 監査人の再任および2026年度の監査費用の決定
4. 取締役の再任および取締役会に対する取締役報酬決定の権限付与
5. 株式の発行および買い戻しに関する一般マンデートの提案
6. 定款(Articles of Association)の改定提案
7. 株主総会開催手順に関するポリシーの改定提案
8. 取締役会開催手順に関するポリシーの改定提案
9. 取締役および上級管理職の報酬管理システムに関する改定提案

8. 未確認事項まとめ

本レポートの調査プロセスにおいて、以下の事項は品質指針に基づく企業公式の一次情報ソースから事実を特定できなかったため、未確認事項として除外または記録する。

- **SM Investments Corporation**に関する情報の除外: 調査中に収集された情報の一部(フィリピンのSM Investments Corporationに関するIRページ等)は、ページ上に記載された商号が対象企業であるSemiconductor Manufacturing International Corporation(SMIC)と一致しな

い別法人であるため、全件採用を見送った。

- ニュースメディアおよび民間調査レポートの除外：通信社、調査会社（Coherent Market Insights等）、および金融データ集約サイト（Sina Finance、Yahoo Finance等）で言及されているSMICの市場シェア、製品採用の噂、または第三者による技術評価に関する内容は、本調査で指定された「引用可の一次情報（企業公式または公的DB）」に置換できなかったため、事実として記載していない。
- **2024年の特定指標（未照合）**：一部のニュース記事において、「2024年末時点のSMICの累計特許出願数は20,108件、累計授權特許数は13,964件」「2024年の研究開発費用は54.5億人民元（売上高の9.4%）」「2024年の研究開発人員数は2,330人（従業員全体の12.1%）」とする記述が散見されたが、本調査でアクセスした公式Annual Report（USD表記の財務諸表）等の範囲内では、これらの人民元表記の数値および2024年の研究開発人員数を直接的に裏付ける箇所を特定できず、今回の調査では未確認として扱う。
- **2026年第2四半期以降の特許出願件数**：現在日付（2026年6月11日）時点における最新の公式開示資料を確認した範囲では、2026年に入ってからの新規特許出願および取得状況の実績数値は特定できない。

引用文献

1. 中芯国际集成电路制造有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案, <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037065.PDF>
2. <https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0408/2026040801181.pdf>
3. 中芯国际集成电路制造有限公司2025 年半年度报告, <http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608545.PDF>
4. SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION 中芯國際集成電路製造有限公司M ANNOUNCEMENT OF 2025 ANNUAL RE - HKEXnews, <https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0326/2026032601294.pdf>
5. - 1 - Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the conten, <https://newsfile.futunn.com/public/NN-PersistNoticeAttachment/7781/20260514/12159222-0.PDF>
6. SMIC-SMIC Announces Ultra High Density IP Library for 0.11um Cu-BEoL Process, http://smicuat.webfoss.com/en/site/news_read/4444
7. SMIC-SMIC Reports Results for the Three Months Ended September 30, 2011, http://smicuat.webfoss.com/en/site/news_read/4388
8. SMIC-SMIC(BJ) Passes QC 080000 System Audit, http://smicuat.webfoss.com/en/site/news_read/4310
9. SMIC-Semiconductor Manufacturing International (Chengdu) Corporation Holds Grand Opening Ceremony for Assembly and Testing Facility, http://smicuat.webfoss.com/en/site/news_read/4279
10. SMIC Receives Sony "Green Partner" Certificates, http://smicuat.webfoss.com/jp/site/news_read/4278
11. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD. - SEC.gov, <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046179/000114554907001718/h01526>

- [e6vk.htm](#)
12. Business Review - HKEXnews,
<http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2007/0430/00981/EFW109.pdf>
 13. TSMC FORM 6-K - SEC.gov,
<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046179/000114554905000134/u99511e6vk.htm>
 14. Correspondence Letter - SEC.gov,
<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1267482/000119312507073488/filename1.htm>
 15. 中芯国际(688981)_公司公告_中芯国际:2024年年度报告新浪财经,
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=688981&id=10814201
 16. 公司公告_中芯国际:2025年半年度报告新浪财经,
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=688981&id=11404599
 17. - 1 - Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the conten,
<https://newsfile.futunn.com/public/NN-PersistNoticeAttachment/7781/20260210/12020546-0.PDF>
 18. 中芯国际:2025年年报 - Moomoo,
<https://www.moomoo.com/hans/news/notice/306879368/smic-2025-annual-report>
 19. annual report - 2024 - HKEXnews,
<https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0409/2025040900322.pdf>
 20. SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION M (1) DISCLOSEABLE TRANSACTION AND CONNECTED TRANSACTION REGARDING THE ACQ - HKEXnews,
<https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0127/2026012701265.pdf>
 21. SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION M (1) PROFIT DISTRIBUTION PLAN FOR THE YEAR 2025 (2) PROPOSED ENGAGEMENT I - HKEXnews,
<https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0603/2026060300988.pdf>